

6, 8インチウェーハ対応ソルダーバンプ形成用N₂リフローシステム Nitrogen Reflow Furnace for the Solder Bump formation of 6 and 8 inch Wafer

NRV-101V6W/ LU

N₂ REFLOW SYSTEM FOR WAFER BUMP

半田ボール搭載後または印刷後のバンプ形成用N₂リフロー装置!

It is the N₂ Reflow furnace for the solder bump formation after the ball attaching or the solder printing!

半田めっき処理後のバンプ形成用ウェットバック装置として!

It is the wet back furnace for the bump formation after the solder plating process!



入口部ロボットハンドリング機構内蔵のスタンダードタイプ
Standard type with a built-in robot handling mechanism at entrance.

ロボットなしのベルト搬送タイプ
Belt transfer type without a robot

主な特長

1. 加熱方式はホットプレートと上部遠赤外ヒーターの併用。直接熱伝導により温度分布の均一化が図れます。
2. ロダー・アンローダー一体型設計。
お客様のマガジncasetにに合わせて設計を致します。
3. 炉内へのハンドリングは、3軸クリーンロボットを装備。よって上流機とのインライン化が容易にできます。またロボットなしのベルトコンベア搬送のローコストタイプも製作可能です。
4. 炉内搬送は、ウォーキングビーム(PAT.P)によるタクト送り。従来のコンベア炉と比較し装置をコンパクトにできます。
5. オプションにてフラックス用スピナーも内蔵できます。
6. オプションにてフラックス燃焼用バーンオフユニット(PAT.P)も装備できます。

Major features

1. The heating system uses a hot plate and a far infrared heater for upper areas. Its direct heat conduction helps realize the uniform distribution of temperature.
2. Design of an integrated loader and unloader. We design the system to our customer's magazine cassette.
3. A three axis clean robot is equipped for handling in the furnace. Thus, inline consolidation with the upstream machine can be easily set. Besides, we are ready to manufacture a low cost type belt conveyor transfer unit without using a robot for transfer.
4. Transfer inside the furnace uses tact feeding with walking beams. (Pat. pending) The equipment can be made compact in comparison with conventional conveyor furnaces.
5. Also, an optional flux spin coater can be equipped.
6. Furthermore, a burn-off unit (Pat. pending) for flux combustion can be equipped as optional.

YAMATO WORKS CO.,LTD.